パーパスとバリューの実践を可視化する取り組み「Resonac Pride 製品・サービス」

詳細はWEB

当社は、先端材料パートナーとして時代が求める機能を創出することで、パーパス「化学の力で社会を変え」て、「人々の幸せと豊かさ」「地球との共生」を実現していきます。そのためには、バリューチェーンの川中から川下まで幅広い領域にある当社の製品・サービスが、社会や環境、お客さまに、どのような価値を、どのくらい提供することができたかを可視化していくことが重要だと考えています。

Resonac Pride 製品・サービスの認定数をマテリアリティ「イノベーションと事業を通じた共創力&競争力の向上と社会価値の創造」達成のためのKPIと位置づけ、役員報酬とも連動させて取り組みを進めています。

Resonac Pride 製品・サービス 認定ステップとポイント

審査のステップ

STEP1 事業部門が認定に向けた申請を実施
STEP2 事務局によって初期審査を実施
STEP3 ステークホルダーからのご意見収集
STEP4 サステナビリティアドバイザーからのご意見収集
STEP5 サス推で社内審査を実施
STEP6 パーパス実現により貢献した製品・サービスを認定
STEP7 ご意見をいただいた方へ報告
STEP8 取締役会へ報告

Point! 認定のポイント

パーパスの実践内容	社会・環境・顧客への提供価値（可能な限り定量化）+社会価値創造ストーリー（仮説、定性）
バリューの実践内容	四つのバリューの実践内容
リスクの評価	第三者から見たリスク、ネガティブインパクト
世界共通のゴールとの関連性	SDGsへの貢献内容
将来へのチャレンジ	将来の事業機会の拡大可能性、規模化
財務影響	将来の売上・利益・キャッシュフローへの影響

●認定の進捗状況

2024年にケミカルプラスチックリサイクル（KPR）とパッケージングソリューションセンター（PSセ）の取り組みについて認定完了しました。現在、他の事業の代表製品・サービスについて、各々、社会・環境・顧客への提供価値可視化に取り組んでいるところです。2025年末までに全事業の代表製品・サービスについて認定できるよう進めています。さらに、2025年から役員報酬のインセンティブ部分のKPIに、本件認定数を含めました。また、より客観性を高めるために、有識者（サステナビリティアドバイザー P83）からご意見をいただくステップを追加しました。

		2024年	2025年	2026年～
事業	エレクトロニクス事業本部	認定完了（第2号:PSセ）	—	2事例目の認定
	ハードディスク事業	—	認定予定	
	デバイスソリューション事業	—		
	モビリティ事業本部	—		
	機能材料事業本部	—		
	基礎化学品事業	認定完了（第1号:KPR）	—	
	グラファイト事業	—	認定予定	

Resonac Pride 製品・サービス認定第2号
パッケージングソリューションセンター

ステークホルダーとの共創活動
JOINT2参加企業数：14社

パッケージングソリューションセンターは、先端半導体パッケージ技術・最新設備を活用・提供し、お客さまと共創するオープンイノベーションの場です。2018年からコンソーシアム"JOINT"を立ち上げ、社外のステークホルダーとの共創を実現しています。装置・材料メーカー各々が個別最適から脱却し、装置・材料が一体となり最適化を図ることで効率的な開発を可能にしています。PSセの取り組みは、「ステークホルダーとの共創」「技術革新」により社会発展や環境負荷低減の貢献につながっています。

技術革新
半導体パッケージの高密度化
電極間、配線間距離を従来の1/3に

JOINT2 P75

●認定のポイント（抜粋）

- お客さまとの一対一のコラボレーションなどを通じ、特に今注目を浴びている生成AIに使用される次世代半導体パッケージの早期実現に貢献している。
- 半導体パッケージを高密度化することで生成AIの性能向上や、スーパーコンピューターの計算速度向上を実現できる。

パーパスの実践内容	開発期間が従来の3分の1に短縮=上市までの期間が短縮
	例えば、生成AIの性能向上やスーパーコンピューターの計算速度向上
バリューの実践内容	「枠を超えるオープンマインド」をはじめ全てのバリューを発揮
世界共通のゴールとの関連性	7:エネルギー、9:産業と技術革新、12:つくる・つかう責任などに貢献
環境への貢献	性能当たりのGHG排出量90%以上削減
将来へのチャレンジ	米国でのJOINT活動開始など国内外での共創活動拡大
財務影響	2026年時点でのエレクトロニクス事業における貢献売上額を確認

社会の発展への貢献

例えば
- **生成AIの性能向上**
  GPTの進化により社会の労働時間短縮・生産性向上に（業界平均で44%の労働時間に影響）
- **スーパーコンピューターの計算速度向上**
  天気予報の精度向上により解像度が25倍に。急な天候の変化にも対応可能に

環境負荷低減への貢献

例えば
- **GHG排出量の削減**
  高性能半導体パッケージの早期実現により、性能当たりのGHG排出量が90%削減

●ステークホルダーからの声

		パッケージングソリューションセンター（PSセ）に対する期待や改善点
ステークホルダー	共創先	・半導体パッケージ技術の重要度が増しているため、材料・装置に強い日本の維持・強化に期待 ・JOINT2参画企業間での課題抽出の場など交流や人材育成を共に進めたい ・JOINT2参画企業の成果の位置づけの明確化やデバイス企業、ファウンドリーへのビジネス展開に向けた出口戦略の議論を期待
	顧客	・複数企業の材料を含めた多様なプロセスやプロダクト試作による半導体パッケージ業界への貢献度がさらに向上することを期待
	有識者	・半導体業界をリードする共創活動（例:国際規格策定への展開など）を期待 ・本取り組みがどのように当社の成長をドライブしていくかを開示していくことで、共創の意義が社会、投資家、そして従業員にも納得されるものになると期待
	投資家	・AIなどの発展により社会全体で使用するトータルの電力量は増加する。環境への影響を含めた社会全体のシステムレベル向上につながる活動を期待 ・経済面だけでなく社会全体への貢献や人々の豊かさにつなげてほしい

外部評価の状況

■ 選定されているESGインデックス

FTSE4Good Global Index
FTSE Blossom Japan Index
FTSE Blossom Japan Sector Relative Index
MSCI 日本株ESGセレクト・リーダーズ指数
MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数
MSCI 日本株女性活躍指数（WIN）
S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数
SNAMサステナビリティ・インデックス
Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Indexes（GenDi J）

■ 外部からの評価・表彰（一部抜粋）

2025年 7月：グリーン・サステイナブルケミストリー賞 経済産業大臣賞（公益社団法人新化学技術推進協会） WEB
2025年 5月：SX銘柄（東京証券取引所、経済産業省） WEB
2025年 3月：JIPS賞大賞（日本化学工業会） WEB
2025年 2月：日経統合報告書アワード優秀賞（日本経済新聞社） WEB
2025年 1月：防災×減災×サステナブル大賞2025スマーテスアワード最優秀賞（一般社団法人減災サステナブル技術協会） WEB